

## PASTA PARA SOLDAR QUE NO NECESITA LIMPIEZA NC254

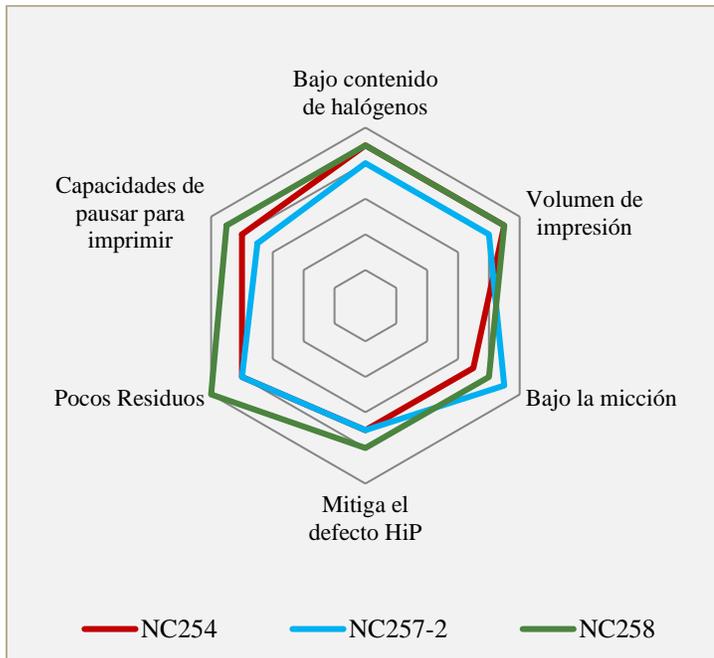
### CARACTERÍSTICAS

- Amplia ventana de procesamiento
- Residuo transparente que se puede probar en sonda de punta
- Sin haluros
- Excelente humectación, incluso en dispositivos sin plomo
- Reduce la formación de vacíos bajo micro BGA
- Vida útil de plantilla: 24 horas
- Tiempo hasta que deja de ser pegajoso: 12-14 horas

### DESCRIPCIÓN

Se desarrolló NC254 para ofrecer ventanas de proceso extremadamente amplias para impresión, humectación y pruebas con sonda de punta. La capacidad de humectación superior de NC254 brinda uniones de soldadura brillantes, lisas y lustrosas. NC254 deja muy pocos residuos después del proceso, que se mantienen transparentes y probable a temperaturas elevadas. NC254 demostró que reduce o elimina la formación de vacíos en BGA. Las tolerancias a las depresiones y la humedad de NC254 prolongan la vida útil de la pasta para soldadura en instalaciones donde el control ambiental no es óptimo.

### CARACTERÍSTICAS



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Aleación	Parámetro	Hora	Temperatura
Sin Plomo	Vida en almacenamiento sellado	9 Months	0°C-12°C (32°F-55°F)
Sin Plomo	Vida en almacenamiento abierto	4 Months	< 25°C (< 77°F)
Con Plomo	Vida en almacenamiento sellado	12 Months	0°C-12°C (32°F-55°F)
Con Plomo	Vida en almacenamiento abierto	N/A	N/A

No agregar pasta usada a pasta sin usar. Almacenar la pasta usada por separado; mantener la pasta sin usar sellada herméticamente con un tapón interno o tapa de extremo colocados. Consultar las pautas de la pasta de AIM para obtener más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC254 para información específica del producto.

### LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura NC254 de plantillas durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de las plantillas. DJAW-10 no secará la pasta NC254 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior de las plantillas. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final de las plantillas.

Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de NC254 pueden permanecer en el conjunto después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria para asegurarse de que los residuos de NC254 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de fundente comunes. Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.

## PERFIL DE REFLUJO

Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

## IMPRESIÓN

Los Ajustes Iniciales Abajo Recomendados Son Dependientes Del Diseño Del PCB Y PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Boquilla	0.10 -0.30 kg/cm (.6 -1.7 lbs/in.) pulgada de la navaja
Velocidad de la Boquilla	25-50 mm/segundo. (1-2 pulgada/Segundo)
Distancia de Desprendimiento	Al contacto 0.00 mm
Distancia de Separación del PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separación del PCB	Lento

## DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC	J-STD-004	ROLO	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruro	
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	PASA	Resultados disponibles a pedido
Migración electroquímica	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1 GR-78-CORE	PASA	Resultados disponibles a pedido
Sólidos del fundente, determinación de no volátiles	J-STD-004 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	96.7% Típico	
Valor Ácido Determination	J-STD-004 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	114 mg KOH/g flux Típico	

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Viscocidad	J-STD-004 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	300-900 Kcps	
Visual	J-STD-004 3.4.2.5	Gris, Suave, Creмоса	
Prueba de Slump de la Soldadura en Pasta	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Fuerza de Adhesion	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	34.2 gf Tipico	